

レーザー協会 第202回研究会

「新たなレーザーアプリケーションと周辺技術」

開催日時:令和7年5月21日(水) 14:30~17:00

会場:中央大学理工学部5号館1階5138号室
(東京都文京区春日1-13-27、最寄り駅:後楽園駅、春日駅、水道橋駅)

開催形式:対面形式



研究会主旨:レーザー加工は、切断や溶接を中心に産業界に広く普及してきましたが、最近では、発振器や光学技術、加工技術の進歩により、乾燥、クリーニング等のレーザーを用いた新たなアプリケーションの実用化が進んでいます。本研究会では「新たなレーザーアプリケーションと周辺技術」と題し、レーザー発振器およびレーザー周辺技術、加工技術に関わる企業より3名の講師をお招きし、講演を予定しています。万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

14:30~14:35 開会挨拶

レーザー協会会長

14:35~15:20 講演1

「半導体レーザー加工によるカーボンニュートラルへの提案」

レーザーライン株式会社 皆川 邦彦氏

15:20~16:05 講演2

「レーザークリーニングによるカーボンニュートラル(仮題)」

東成エレクトロビーム株式会社 西原 啓三氏(仮)

16:05~16:50 講演3

「アプリケーションに対応した各種カスタマイズヘッド(仮題)」

株式会社レーザーックス 大江 浩史氏、小澤 健治氏

16:50~17:00 閉会挨拶

レーザー協会副会長

【参加費】 会員:無料 非会員:7,000円(当日お支払い下さい)

【申込先】 レーザー協会ウェブページ <http://jslt.jp/> の申込みフォームよりお申し込み下さい。

・参加申込〆切:令和7年5月14日(水)

【問合せ先】 レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp